

# ÉVÉNEMENT

compte-rendu

## Zuken : Engineering Days

**Environ 70 personnes avaient répondu présent à l'invitation de l'éditeur Zuken pour découvrir son offre 2010 en matière de CAO électronique/électrique.**

### Intégration plus étroite

La société japonaise Zuken s'est taillé une place confortable dans l'édition des logiciels d'EDA avec une croissance régulière de son périmètre. Normal, la mécatronique a le vent en poupe et l'embarqué ne s'est jamais aussi bien porté. L'éditeur réalise environ 70 % de son chiffre d'affaires sur son marché intérieur, et 19 % sur le

vieux continent. Reste que la crise est passée par là. Les revenus ont donc baissé de 225 M\$ en 2008 à 202 M\$ à fin mars 2009 et le résultat d'exploitation a été divisé par deux... Ce qui n'empêche pas l'entreprise nipponne d'aller de l'avant avec le lancement de nouveaux produits et modules complémentaires comme Design Gateway permettant de concevoir le circuit électronique et son matériel support, ou bien

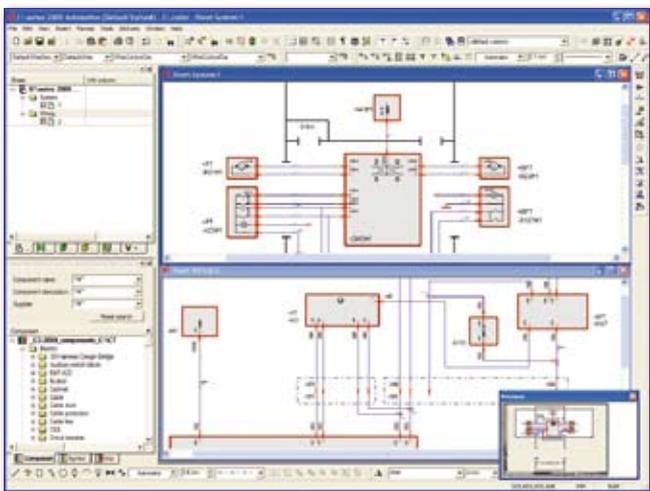
E<sup>3</sup>.widgen pour la création automatique du schéma fonctionnel de câblage à partir d'une liste « From-To ». Et comme l'expliquait Francesco De Cet, directeur des ventes France et Italie, « nous devons répondre à la fois à des problèmes techniques, avec des fonctions nouvelles, et à l'évolution structurelle de nos clients, avec la mise en place d'outils facilitant le partage de données et la collaboration étendue ».

Stratégiquement, Zuken poursuit sa route à travers une offre clairement orientée métier. E<sup>3</sup>.series pour l'électricité, CR 5000 pour l'électronique et DS2 pour gérer les données d'ingénierie qui proviennent des deux premiers outils. Mais, impossible désormais de concevoir de tels produits sans se soucier de leur intégration. C'est pourquoi l'entreprise noue des liens étroits avec les principaux éditeurs de CAO mécanique afin de faciliter les échanges de données d'un

soft à l'autre. L'interface E<sup>3</sup>.3DRoutingBridge, par exemple envoie des informations d'E<sup>3</sup>.series vers le système de CAO mécanique, telles que les désignations d'appareils, les informations sur les composants et les interconnexions. En retour E<sup>3</sup>.series reçoit les informations structurales comme la longueur des fils. L'ensemble des fonctionnalités est dépendante du système de CAO mécanique utilisé et inclut typiquement le contrôle des rayons de courbures, des collisions, les placements de fixations, etc.

### Trio gagnant : environnement, sécurité et médical

A l'occasion de cette journée, le cabinet d'étude Décision a dressé un tableau fort complet du marché de l'électronique en Europe, dont voici les grandes lignes. L'électronique couvre aujourd'hui de très nombreux secteurs avec en tête de liste l'informatique, les Télécoms et l'aéronautique/défense. L'activité pèse sur le plan mondial



La version 2010 d'E<sup>3</sup>.series apporte de nombreuses petites améliorations notamment de l'interface accélérant les modifications et les mises à jour automatiques qui en découlent.

1140 milliards d'euros, ce qui correspond à environ trois fois les revenus générés par les transports aériens ! Notons que 50 % de la production est assuré par l'Asie.

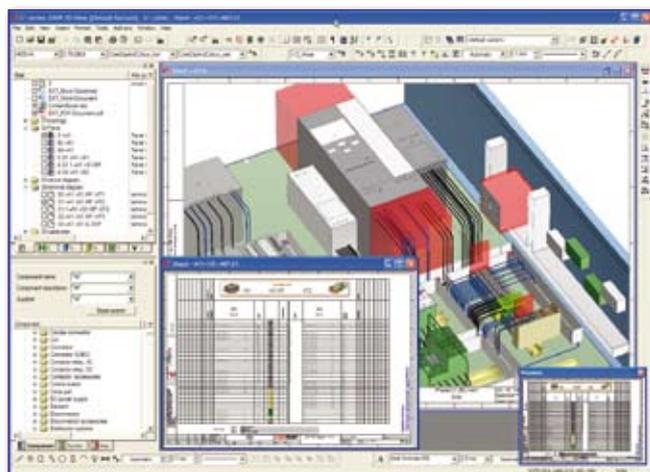
L'impact de la crise mondiale ? Evidemment des échanges en diminution de 7 % en 2009, mais qui devraient remonter à +1,6 % en 2010, et présenter un rebond de près de 6 % en 2011. Finalement, la crise aura limité la croissance de l'activité électronique à + 2,7 % sur cinq ans, contre + 6 % selon les prévisions standards. C'est en Europe que la baisse est la plus forte en valeur de production.

Une fois la crise passée, ce sont trois secteurs qui devraient tirer vers le haut les métiers de l'électronique : l'environnement (économie d'énergie/transport...), la sécurité (infrastructures, protection des biens et personnes...) et le médical (bien-être, équipement hôpital et maison...). Mais il faudra sans doute attendre cinq années pour retrouver un volume d'affaires comparable à celui de 2008 en Europe.

## Témoignage client

Constructeur international de machines façonnant des emballages, Bobst a récemment décidé de fédérer tous ses développements électriques autour d'une seule solution de CAO, en l'occurrence Zuken E<sup>3</sup>.series. Pour l'instant, six sites utilisent cet outil. Le projet porte

sur son extension à cinq autres entités. Le logiciel de Zuken est utilisé pour concevoir les équipements électrotechniques, mais également les équipements de transport des fluides, les industrialiser et éditer les documents de production. Plusieurs modules sont mis à contribution pour cela pour tous les BE : Câble, Panel, Schematic, Fluidic, et Viewer. « Notre marché exige de nous une grande agilité : *« design anywhere, produce anywhere »*. Pour cela, nous devons harmoniser nos méthodes de travail et nos outils autour d'un standard unique. Nos services



*Il est désormais possible d'éditer et de modifier comme dans un tableau Excel les tables pour différents objets et attributs dans E<sup>3</sup>.series.*

de R&D seront plus efficace, les données échangées gagneront en qualité tout comme les documentations techniques produites et nous serons capables de travailler sur le même projet distribué sur plusieurs sites » explique Jean-Pierre Guillin, représentant du constructeur.

Plus facile à dire qu'à faire... Techniquement, il s'agit de déployer une base de données unique, d'assu-

rer sa réplique hebdomadaire dans chaque site du groupe, et de la lier avec le cPDM d'entreprise, en l'occurrence SAP. Bobst a par ailleurs mis en place deux centres de compétences qui développent les produits spécifiques (relais, variateurs...), disponibles aux autres entités du groupe à travers une base de données Oracle, elle-même répliquée toutes les semaines sur les différents sites ! L'entreprise doit également partager les applications qu'elle a déjà pu développer autour d'E<sup>3</sup>.series et mettre en place un dispositif permettant de synchroni-

ser, tous les deux ans, le passage de toutes les licences à une nouvelle version. Elle doit enfin généraliser ses méthodes de travail, ainsi que la représentation de tous les livrables. Dernier chantier à ne pas négliger : la migration sous E<sup>3</sup>.series des 15 000 dossiers développés sous l'ancien système ! Du pain sur la planche pour Bobst en perspective...



## E<sup>3</sup>.series : les nouveautés V2010

Difficile de détailler toutes les nouveautés disponibles dans les nouvelles versions des outils de la gamme E<sup>3</sup>.series. Rien de révolutionnaire, mais de nombreuses améliorations de l'interface. On retiendra les plus marquantes comme la possibilité d'éditer et de modifier comme dans un tableau Excel les tables pour différents objets et attributs, le contrôle de l'affichage des fenêtres de premier et d'arrière-plan ou encore le drag & drop d'objets à partir de l'arborescence du projet directement dans un autre projet. Notons également le support des dernières versions des formats DXF/DWG et la possibilité de répliquer les bases de données composants/symboles (Oracle et Microsoft SQL Server). E<sup>3</sup>.panel bénéficie, lui aussi, d'améliorations avec par exemple la mise en place des points d'accroche lors du placement des composants, la sortie directe via Direct3D, l'affichage des modèles Step, les modèles modifiables dynamiquement ou encore la possibilité de placement de modèles 3D simplifiés. ♦